

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-66

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	兴银理财、德邦基金、国投瑞银基金、诺德基金、西部证券、诺安基金、华富基金、华泰柏瑞基金、宏利基金、中信保诚基金、国金基金、东吴人寿、淡水泉、财通基金、天弘基金、百年保险资管、上海东证资管、博时基金、汇添富基金、太平资产、圆信永丰基金、杭银理财、人保资产、华泰资产、兴业基金、申万菱信、太平基金、招商证券、浙商证券
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2024年11月6日
地点	招商证券策略会举办地、浙商证券策略会举办地
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司2024年三季度经营业绩情况。</p> <p>2024年前三季度，公司累计实现营业收入130.49亿元，同比增长37.92%，归母净利润累计实现14.88亿元，同比增长63.86%，扣非归母净利润累计实现13.76亿元，同比增长86.67%。单季度层面，2024年第三季度公司实现营业收入47.28亿元，同比增长37.95%，归母净利润实现5.01亿元，同比增长15.33%，扣非归母净利润实现4.72亿元，同比增长51.53%。</p> <p>上述变动主要得益于公司把握2024年以来行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，报告期内订单同比增长，三项主营业务收入均实现同比增长，同时由于AI的加速演进及应用深化，叠加汽车电动化/智能化趋势延续，以及服务器总体需求回温等因素，推动公司产品结构优化，助益利润同比提升。</p> <p>Q2、请介绍公司2024年第三季度营业收入及综合毛利率环比变化情况。</p>

2024年第三季度，公司营业收入47.28亿元，环比增长8.45%，主要由于电子装联业务项目结算增加影响，营收规模环比增加。公司综合毛利率环比略有下降，一方面由于电子装联业务规模增长（因业务形态特点，其毛利率一般略低于公司综合毛利率）；同时封装基板及PCB业务受产品结构变化影响，业务毛利率环比下降。此外，广州封装基板新工厂产能爬坡、原材料涨价对第三季度综合毛利率也造成一定负向影响。

Q3、请介绍公司2024年第三季度PCB业务各下游领域经营拓展情况。

公司PCB业务产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2024年第三季度，受通用服务器需求及国内汽车电子产品需求增长影响，公司PCB业务营收在数据中心及汽车电子领域环比二季度有所提升，通信领域受无线侧通信基站相关产品需求无明显改善影响，营收占比有所下降。

Q4、请介绍公司2024年前三季度PCB业务在数据中心领域经营拓展情况。

数据中心是公司PCB业务重点布局领域之一，聚焦服务器、存储及周边产品。2024年前三季度，全球主要云服务厂商资本开支重点用于算力投资，带动AI服务器相关需求增长，叠加通用服务器EGS平台迭代升级，服务器总体需求回温。公司数据中心领域订单同比显著增长，主要得益于AI加速卡、EGS平台产品持续放量等产品需求提升。在新产品预研方面，公司已配合下游客户开展下一代平台产品研发、打样工作。

Q5、请介绍公司PCB业务有无进一步扩产的空间。

公司PCB业务在深圳、无锡、南通及未来泰国项目均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟PCB工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖HDI等能力的PCB工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q6、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。

公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为12.74亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设有序推进中，具体投产时间将根据后续建设

	<p>进度、市场情况等因素确定。</p> <p>Q7、请介绍公司 2024 年第三季度封装基板业务经营拓展情况。</p> <p>公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2024 年第三季度，封装基板下游市场需求有所放缓，公司封装基板产品结构随下游市场需求波动有所调整。</p> <p>Q8、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 及封装基板工厂稼动率较第二季度变化情况。</p> <p>公司 2024 年第三季度 PCB 工厂稼动率环比基本持平，维持在高位水平；封装基板工厂稼动率随下游部分领域需求波动略有回落。</p> <p>Q9、请介绍无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。</p> <p>公司无锡基板二期工厂于 2022 年 9 月下旬连线投产，目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年上半年快速提升，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作。</p> <p>Q10、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。</p> <p>公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，16 层以上产品具备样品制造能力，其中 20 层产品送样认证工作有序推进中。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>